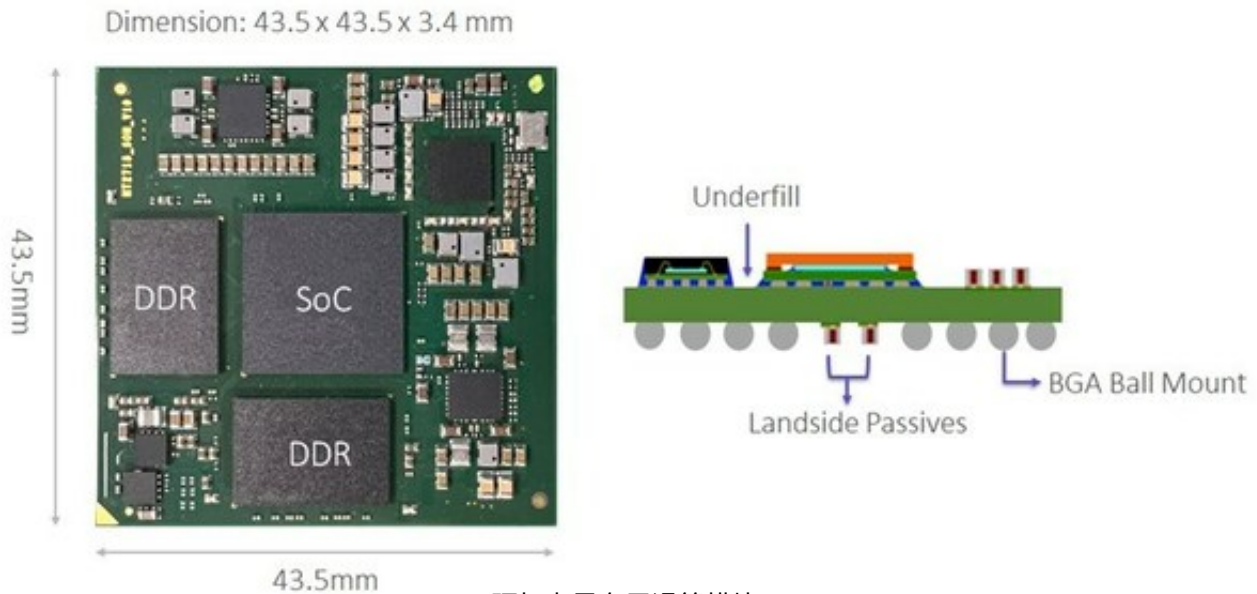


环旭电子为智能座舱系统带来革新

上海2023年7月19日 /美通社/ -- 随着电动车和先进驾驶辅助系统的蓬勃发展，汽车行业正处于迅速发展的智能驾驶时代。为了提升操控性能和乘坐体验，众多车厂纷纷积极导入崭新的电子装置和技术，并致力于实现更先进的智能座舱系统。在这一蓬勃发展的领域中，环旭电子（上海证券交易所股票代码：601231）现正与多家车用SoC方案原厂（TP）携手合作，凭借多年深耕SiP/SoM模块将车用运算模块（Automotive Compute SiP/SoM Module）进一步微缩，同时确保DDR最高指令周期，从而协助品牌车厂及Tier1加速智能座舱系统的开发。



环旭电子车用运算模块

如今的智能座舱系统，已不仅仅提供有限的信息娱乐功能，如CD拨放器、USB和蓝芽联机等，而是快速演进至具备乘客娱乐显示、环景辅助显示、抬头显示器、数字仪表显示、驾驶侦测、乘客侦测、声控调整温度、声控播放音乐和传送讯息等丰富功能。这样的进展让驾驶者能在车辆中感受到类似飞机驾驶座舱的尊贵体验，极大地提升了驾驶舒适感和操控性能，同时减轻了驾驶疲劳。

智能座舱系统不仅实现了移动私人娱乐中心的功能，更随着人工智能（AI）辅助、先进联网功能（C-V2X）、先进驾驶辅助系统（ADAS）和软件定义汽车（SDV）的演化趋势，不断推陈出新。这些趋势将进一步带动智能座舱系统往下列应用场景发展：

- 智能化人机界面：现今屏幕触控人机接口已成为主流方式。然而，在未来，随着人工智能（AI）辅助的逐步导入，传统的实体触摸屏幕方式可能会逐渐被先进的语音声控、手势控制甚至眼球控制所取代。
- 多元化座舱功能：未来的智慧座舱将结合全自动驾驶技术，成为多元智慧办公及娱乐中心。驾驶员及乘客可以在车舱中进行办公工作、会议、影音娱乐等活动。

基于这样的发展趋势，明显可见对系统单芯片（SoC）和主动被动电子组件的市场需求将大幅增加。因CPU指令周期的提高及功能变的更多，如果仍采用传统的chip-on-board方案，主板需要改用10层以上的HDI PCB，然而模块化设计就能减少迭构及设计复杂度。

环旭电子采用先进底部充填、BGA植球、植球面被动组件及高密度SMT制程技术，所开发出来的车用运算模块包括运算SoC、动态随机存储内存（DDR）和电源管理（PMIC）等重要控制组件，并将其独立于主板之外。这种模块化设计不仅减少了主板面积，提升了运算效能（例如运算速率和配电网络表现），还能提升驾驶座舱系统的质量和效能。同时，车厂可以专注于主板的开发，从而减少整体开发时间，节省研发成本。此外，采用车用运算模块还能降低车厂主板的成本，使得高迭构层次的PCB设计在较小面积的模块内。

环旭电子一直致力于推动汽车科技的革新，在车用运算模块产品有丰富的开发经验，公司能够提供各种优良先进的

车用运算模块，为新型座车的驾驶员和乘客带来更加安全、便捷和令人兴奋的驾驶体验。环旭电子的解决方案不仅为汽车制造商提供全面的技术支持，同时实现提升产品质量与效能、缩短开发时间，并降低研发人力成本。

随着智能座舱系统市场的不断发展，环旭电子将继续引领车厂进入这个全新纪元，为未来汽车行业的智能化发展注入强劲动力。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/198074.html>